

【特徴】【原因、判断要点、发生工序】在层压工序，外层铜箔面压着的B片屑成为ET剂而引起的（多层板层压～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Prepreg debris adhered on the copper foil of the outer layer by pressure in multilayer lamination acts as etching resist causing the defect. (Multilayer lamination - etching process)



【コメント】
プリプレグの下に積層銅箔が残っている
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
在B片下面的层压铜箔
显微镜倍率 ×

【Comments】
A part of copper foil remains under prepreg debris
Magnification: ×

1-5-1-8 压着突起／压着铜屑的凸出／ Outward conductor projection by adhered debris

【特徴】 导体表面に銅箔屑等が压着されて导体幅の外側に飛び出している状態の突起

【特征】 导线表面压着铜屑等，导线幅向的外侧鼓起的凸出。

【Characteristics】 Conductive debris of copper foil, etc is press-adhered to the conductor surface and protrudes extending out from the conductor width.

【原因・判断ポイント・発生工程】 回路形成後の导体部に导体幅より大きい銅屑等が压着されて出来たもの（回路形成後の基板積み重ね、外形打ち抜きプレス工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在图形转移后，导线上压着比线宽大的铜屑而引起的（图形转移后的堆垛、冲外形工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Conductive debris of copper, etc. larger than the conductor width is adhered by pressure to the conductors formed (Board stacking after forming conductor pattern, punching process)



【コメント】
压着突起と压着表面突起が同居している
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
压着铜屑的凸出和压着小铜屑的凸出并存
显微镜倍率 ×

【Comments】
Outward and upward conductor projections by adhered debris coexists.
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

1-5-1-9 压着表面突起／压着小铜屑的凸出／ Conductor projection by adhered debris

【特徴】 导体表面に导体幅をはみ出さない状態で銅箔屑等が压着され、导体表面に突き出している状態の突起

【特征】 导线表面压着比线宽小的铜屑等，在导线表面鼓起的凸出。



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×